



平成 25 年 4 月 24 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社
代 表 者 代表取締役社長 岡田 博和
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 岸本 昌利
TEL (075) 692 - 0251

韓国・台湾地域における事業活動の強化について

当社は、韓国・台湾地域における事業活動をさらに強化するため、下記のとおり新会社の設立(韓国)ならびに合弁会社の連結子会社化(台湾)を実施いたしましたので、お知らせ致します。

記

1、韓国地域

(1) 新会社の設立

会社名 : T O W A 韓国株式会社
所在地 : 大韓民国ソウル市
株主構成 : T O W A 株式会社 1 0 0 %
設立日 : 平成 25 年 4 月 8 日

(2) 設立目的

韓国地域には大手 I D M をはじめ多くの半導体メーカーの工場があり、各工場への設備投資額も非常に大きくなっております。また、次世代の半導体パッケージ開発を行う拠点も多く、当社の事業戦略においては、これらの半導体メーカーに対する技術営業や次世代装置の共同開発などを積極的に進めることが重要となっております。当社はこれまで、現地代理店および本社営業本部により韓国地域での営業活動をカバーしておりましたが、同地域の重要性を鑑み、今回、あらたに完全子会社の販売事業会社を設立し、営業活動を開始することと致しました。また、従来の現地代理店は新会社と並存させることで営業活動のマンパワーを十分に確保するとともに、リピート金型専用工場と位置づけている株式会社東進(平成 24 年 4 月に連結子会社化)と新会社との連携を万全にすることで、韓国内での製販一体となった事業活動を展開してまいります。これにより、韓国地域の半導体メーカー各社の金型・装置への投資を確実に捕捉するとともに、その実績を武器に台湾・中国地域の O S A T 各社においても、さらなる当社シェアの拡大を図ってまいります。

2、台湾地域

(1) 「巨東精技股份有限公司」の連結子会社化

当社は、合弁会社(当社持分法適用子会社)である「巨東精技股份有限公司」が行う増資(2.5 百万 NTD)を全額引き受け、当社の出資比率を 6 0 % とし、連結子会社としました。

(2) 「巨東精技股份有限公司」の概要

所在地 : 中華民国台湾高雄市
事業内容 : 装置・金型のアフターサービスおよびパーツ等販売
株主構成 : T O W A 株式会社 60% (増資前 40%)
JIPAL CORPORATION 40% (増資前 60%)

(3) 目的

当社は、当社の最大マーケットである台湾地域において、販売事業会社「台湾東和半導体設備股份有限公司（株主構成：TOWA 株式会社 100%）」および現地代理店「JIPAL CORPORATION」による営業活動を展開しております。当社は、今後さらに台湾地域での事業活動を強化する計画であり、その一環として、現地代理店との合弁会社である「巨東精技股份有限公司」の人的・物的な経営資源を強化し、グループ内における同社の役割を高めることと致しました。同社は台湾全土において当社製品のパーツ販売やアフターサービスを行っており、所属するFSE はお客様の生産状況や投資情報等を入手しやすい立場にあります。当社は、同社を通じたこの情報を新たな製品開発やリピート金型を含めた製品受注へと繋げる仕組みを構築し、台湾地域でのさらなる営業網の強化を図ってまいります。

3、今後の展開について

当社は、半導体モールドイング装置において世界トップシェアをもっております。これはひとえに、「お客様が求めるもの」に絶えず耳を傾け、それをカタチにする「ものづくり企業」に徹し、ひたすらに技術革新を続けてきたことによるものと考えております。

当社は、今後も当社が業界のリーディングカンパニーであり続けるためには、常にお客様の近くでその声を聞ける体制、そしてスピーディーに技術提案ができる人材の増強が必須であると考えております。したがって、今後もさらに海外の営業・サービス拠点を充実させ、グローバルな人材採用も積極的に進めてまいります。

以上